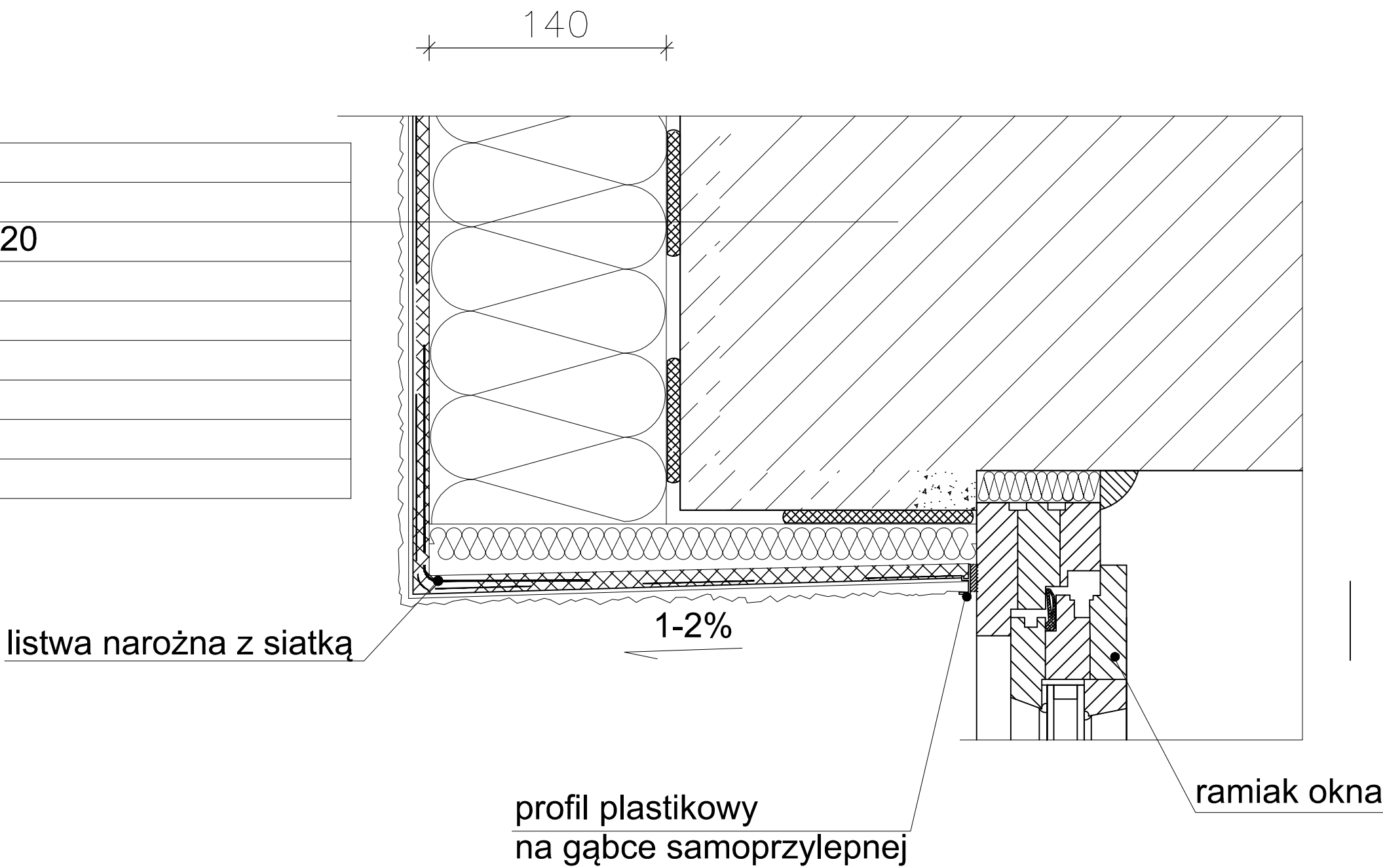
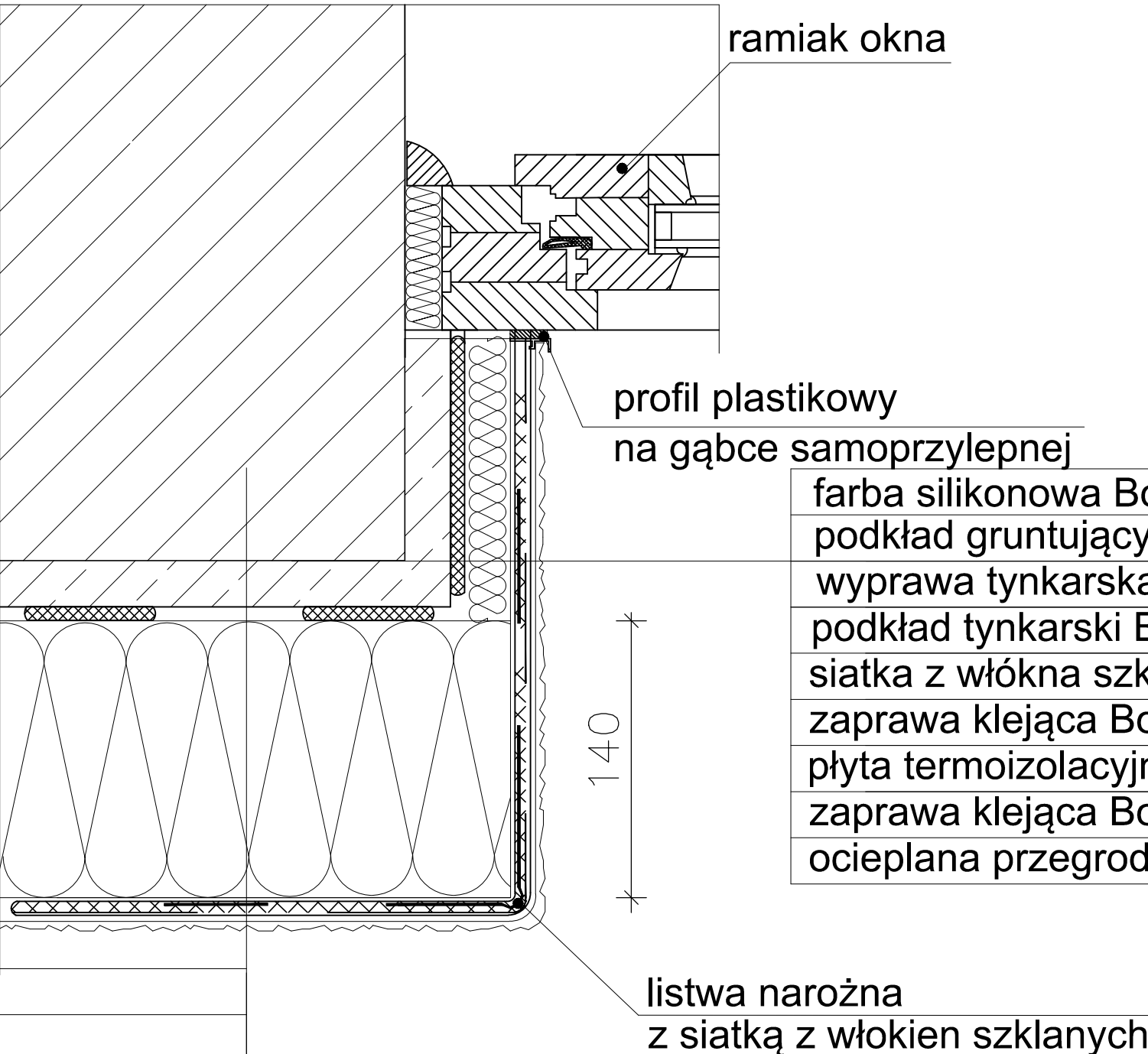


farba silikonowa Bolix SIL
podkład gruntujący BOLIX SIG
wyprawa tynkarska Bolix MP KA 20
podkład tynkarski Bolix OP
siatka z włókna szklanego
zaprawa klejąca Bolix U
płyta styropianowa gr. 14cm λ 40
zaprawa klejąca Bolix U
ocieplana przegroda



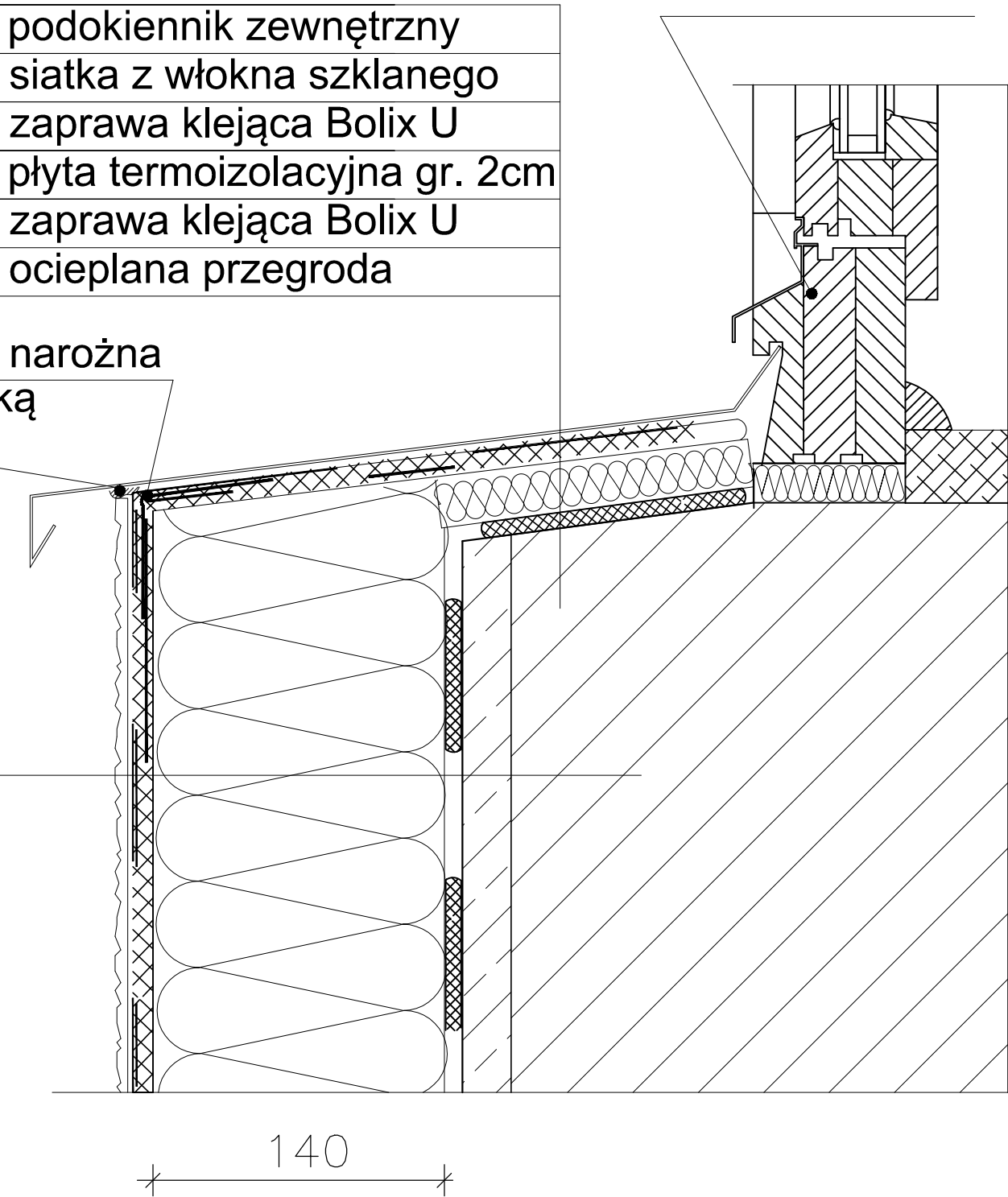
Rys. B-1. Detal ocieplenia styropianem nadproża okiennego

farba silikonowa Bolix SIL
podkład gruntujący BOLIX SIG
wyprawa tynkarska Bolix MP KA 20
podkład tynkarski Bolix OP
siatka z włókna szklanego
zaprawa klejąca Bolix U
płyta termoizolacyjna gr. 2cm
zaprawa klejąca Bolix U
ocieplana przegroda



Rys. B-2. Detal ocieplenia styropianem ościeża okiennego

farba silikonowa Bolix SIL
podkład gruntujący BOLIX SIG
wyprawa tynkarska Bolix MP KA 20
podkład tynkarski Bolix OP
siatka z włókna szklanego
zaprawa klejąca Bolix U
płyta styropianowa gr. 14cm λ 40
zaprawa klejąca Bolix U
ocieplana przegroda



Rys. B-3. Detal ocieplenia styropianem i obróbki blacharskiej podokiennika zewnętrznego

farba silikonowa Bolix SIL
podkład gruntujący BOLIX SIG
wyprawa tynkarska Bolix MP KA 20
podkład tynkarski Bolix OP
siatka z włókna szklanego
zaprawa klejąca Bolix U
płyta styropianowa gr. 14cm λ 40
zaprawa klejąca Bolix U
ocieplana przegroda

Nazwa inwestycji Projekt budowlany docieplenia budynku nr 6 na terenie BUMAR ELEKTRONIKA S.A., 04-051 Warszawa przy ul. Poligonowej 30		
Inwestor BUMAR ELEKTRONIKA S.A. 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30		
Generalny Projektant STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa		
Projektant	mgr inż. Leszek Tischner	nr ewid. 157/2002
Sprawdzający	mgr inż. Damian Cyrla	MAZ/0003/POOK/09
Asystent	mgr inż. Sebastian Galiński	
Asystent	inż. Radosław Lenart	
Tytuł rysunku: Detale B-1, B-2, B-3		
Data: maj 2014 r.	Skala 1:5	Rys. nr: 7